

INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Thermal Design and Simulation of a Circuit Board for Aerospace

TRABAJO FIN DE GRADO 2021-2022



Autor: Miguel Atienza Ariza

Tutor: Andrés María Roldán Aranda

Departamento:

Electrónica y Tecnología de Computadores



ÍNDICE

- 1. Descripción del proyecto
- 2. Objetivos
- 3. Marco teórico
 - 3.1. Transmisión del calor
 - 3.2. Resistencia y Capacidad Térmica
 - 3.3. Análisis térmico
- 4. Diseño con SolidWorks
 - 4.1. Diseño Estructura de Iluminación
 - 4.2. Diseño del Sistema
- 5. Diseño Mecánico
 - 5.1. Estructura de Iluminación
 - 5.2. Montaje y Fabricación de la placa
 - 5.3. Conexiones
- 6. Diseño Software
 - 6.1. GUI
- 7. Validación del sistema
- 8. Conclusiones



1. Descripción del proyecto

En las misiones del espacio profundo no hay convección natural disponible en la Tierra. Los diseños electrónicos para los satélites deben asegurar que la energía disipada por los componentes sea radiada por conducción hasta el borde exterior de la placa donde se transfiere esa energía térmica a la caja que alberga la placa.

Mediante una cámara térmica de vacío (TVAC) disponible en el laboratorio, se realizará un sistema de medición y acondicionamiento de la cámara para la realización de estudios térmicos.





1. Descripción del proyecto

Vacío



Presión de Vacío





Temperatura de la TVAC



Isotemp Chiller

Suministro de Potencia y Medición



Medición temperatura termopares





2. Objetivos

- Acondicionamiento de la cámara térmica de vacío para la realización de pruebas térmicas.
- Desarrollo de un modelo para el estudio de la resistencia de contacto térmico entre dos elementos.
- Desarrollo de un sistema de iluminación y temperatura de la cámara térmica de vacío
- Sistema para medir y controlar el equipo usado.
- Visualización de datos en tiempo real.





3. Marco Teórico: Transmisión del calor

Calor: Intercambio de energía entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura.

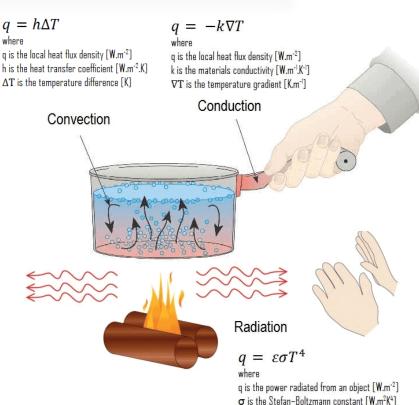
Temperatura: Propiedad escalar, nivel térmico de un cuerpo.

Transmisión del calor:

• Conducción
$$Qcond = \frac{kA(Tf-Ti)}{L}$$

- Convección: Qconv = hA(Ts Tf)
 - Forzada
 - Natural
- Radiación: Qrad = Aε $\sigma(Ts^4 Tf^4)$
 - Ley de Planck
 - Ley del desplazamiento deWien
 - Ley de Stefan-Boltzmann

Mechanisms of Heat Transfer - Convection



ε is the emissivity of the surface of a material [-]



3. Marco Teórico: Resistencia y Capacidad térmica

Analogía con la ley de Ohm

Intensidad

Potencia

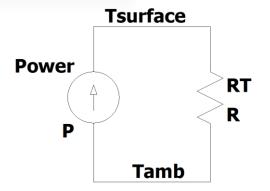
Impedancia Eléctrica Impedancia Térmica

Voltaje



- Resistencia térmica
- Capacidad térmica

Estado Estacionario



$$T_s - T_a = PR_T$$

Resistencia Térmica

$$R_T = \frac{L}{kA}$$

Conductividad Térmica

$$\sigma = \frac{1}{R_T}$$

Conducción de Calor

$$Qcond = \frac{kA(Tf - Ti)}{I}$$



$$Qcond = \frac{(Tf - Ti)}{R_T}$$



3. Marco Teórico: Resistencia y Capacidad térmica

Analogía con la ley de Ohm

Intensidad



Potencia

Impedancia Eléctrica



Impedancia

Térmica

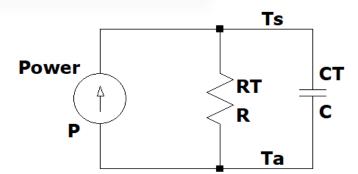
Voltaje



Diferencia de temperatura

- Resistencia térmica
 - Capacidad térmica

Estado Transitorio



Capacidad Térmica

$$C_T = c_s * d * V$$



$$C_T = c_S * m$$

- $C_T =$ Capacidad térmica
- $c_s = \text{Capacidad específica}$
- d = densidad
- V = Volumen que es calentado
- m = Masa



$$T_s - T_a = PR_T (1 - e^{\frac{-t}{R_T C_T}})$$



3. Marco Teórico: Resistencia y Capacidad térmica

Resistencia Térmica: Representa la capacidad del material para oponerse al flujo de calor. Depende de:

- Presión de contacto.
- Características de la superficie.
- Propiedades del material.
- Cargas de contacto.
- Medio intersticial de la interfase.

Capacidad Térmica: Representa la cantidad de calor necesario para incrementar 1 grado la temperatura de una cierta sustancia.



3. Marco Teórico: Análisis Térmico

Simulación Térmica

Modelación del comportamiento térmico del elemento calefactable mediante los parámetros:

- Calor específico.
- Conductividad térmica.

Estacionario

Masa de la resistencia.

Transitorio

Parámetros de una aleación de acero en Simulaciones Térmicas

Property	Value	Units
Shear Modulus	7.7e+10	N/m^2
Mass Density	7800	kg/m^3
Tensile Strength	513613000	N/m^2
Compressive Strength		N/m^2
Yield Strength	172339000	N/m^2
Thermal Expansion Coefficient	1.1e-05	/K
Thermal Conductivity	18	W/(m·K)
Specific Heat	460	J/(kg·K)
Material Damping Ratio		N/A

$$T_s - T_a = PR_T(1 - e^{\frac{-t}{R_T C_T}})$$

$$C_T = c_s * m$$

Masa y Potencia conocidos $P \approx cte$

Estudio Experimental

Para el estudio de la conducción de calor se usarán:

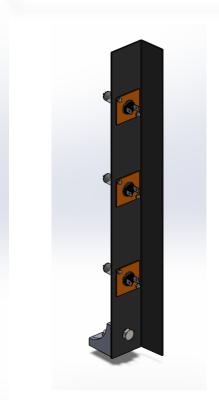
- Resistencia de potencia ARCOL HS50 de 0.5Ω .
- Placa de aluminio de 80x120mm con 6mm de grosor.



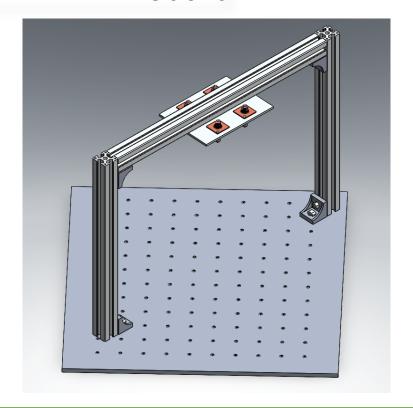


4. Diseño con SolidWorks: Estructura de Iluminación

Versión 01



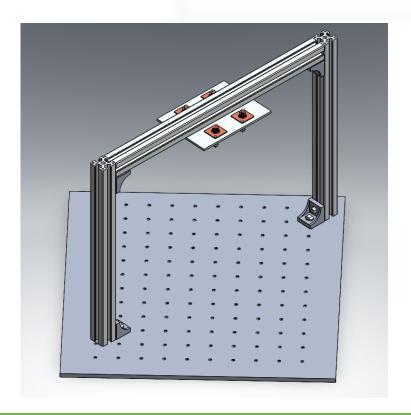
Versión 02





4. Diseño con SolidWorks: Estructura de Iluminación

Elección: Versión 02

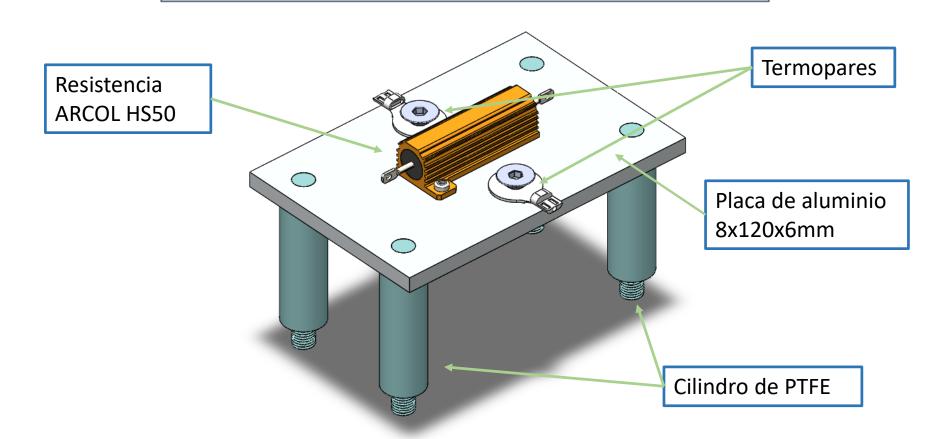




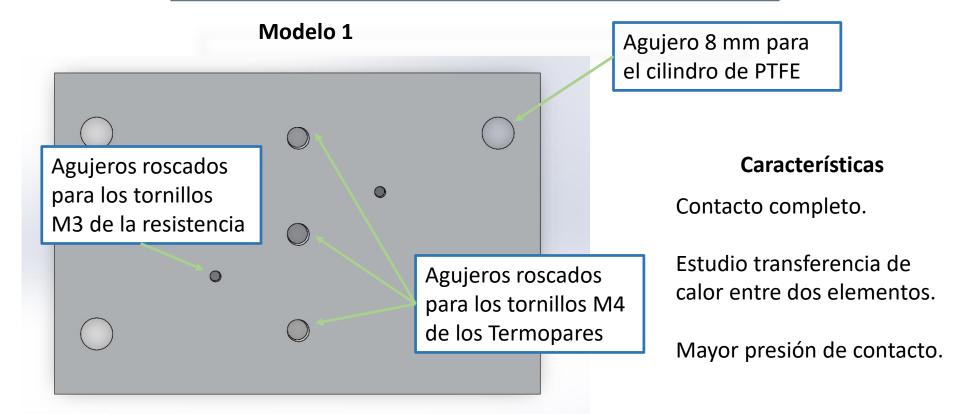
Ventajas

- Incidencia perpendicular de la luz a la placa.
- La estructura permite colgar las resistencias para su caracterización.





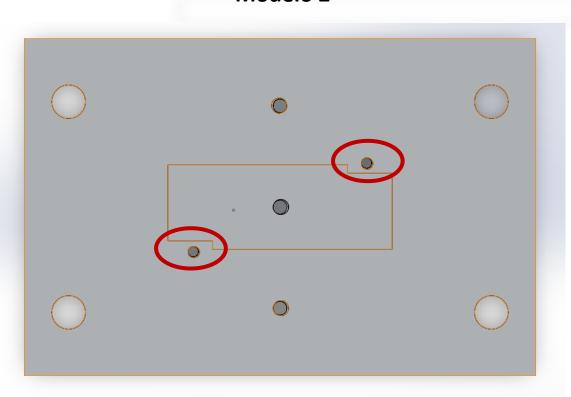








Modelo 2



Características

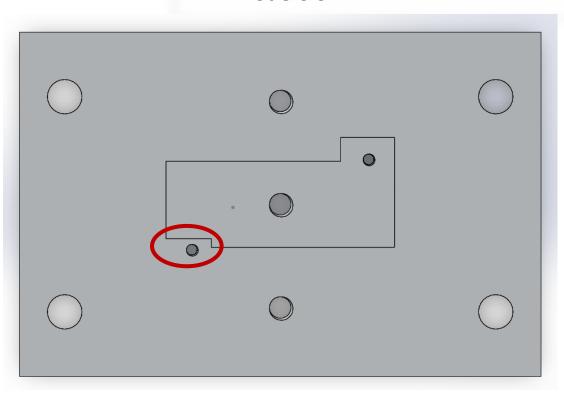
Contacto por 2 de las aletas de la resistencia.

Estudio de la transferencia de calor en la unión por los tornillos.

No se conoce exactamente la conductividad de contacto térmico de cada aleta.



Modelo 3



Características

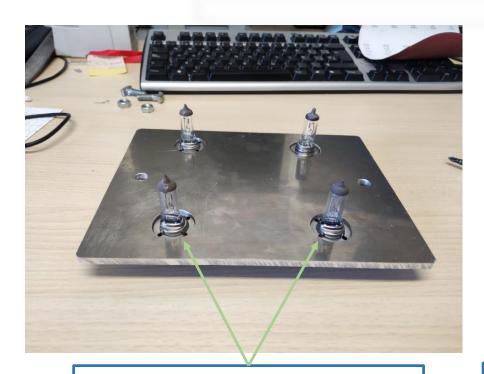
Contacto por una de las aletas de la resistencia.

Estudio transferencia de calor en la unión por un tornillo.

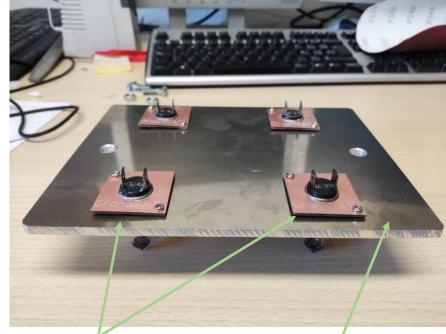
Mayor precisión en el estudio.

Menor presión de contacto.





Bombillas de Halógenos H7 55W



Pletinas de cobre

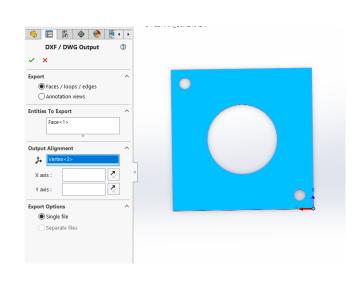
Placa de aluminio

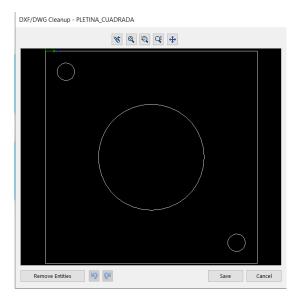


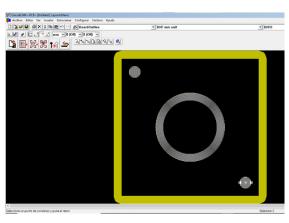


Proceso para la fabricación de las pletinas

SolidWorks DXF CircuitCAM

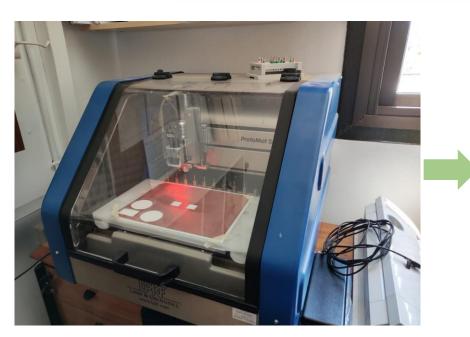








Fabricación de las pletinas











Fabricación de las Placa de Aluminio

Broca escalonado

Resultado final

Diámetro: 26mm

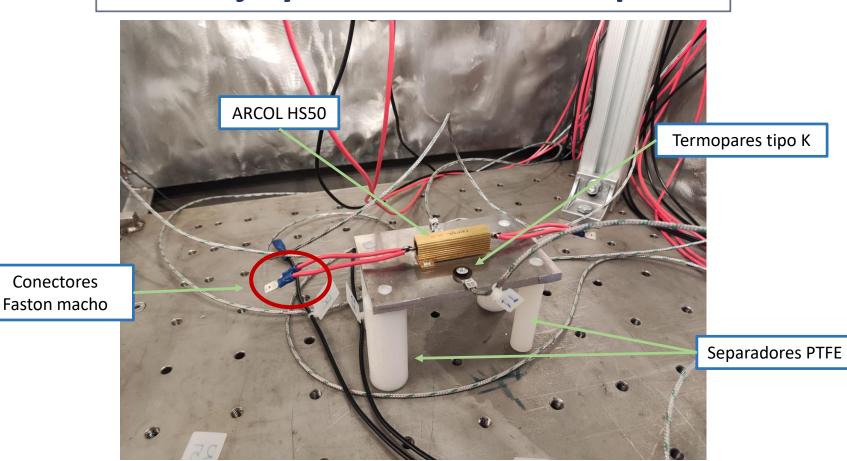
Agujeros roscados M3 no pasantes

Diámetro: 8mm



Conectores

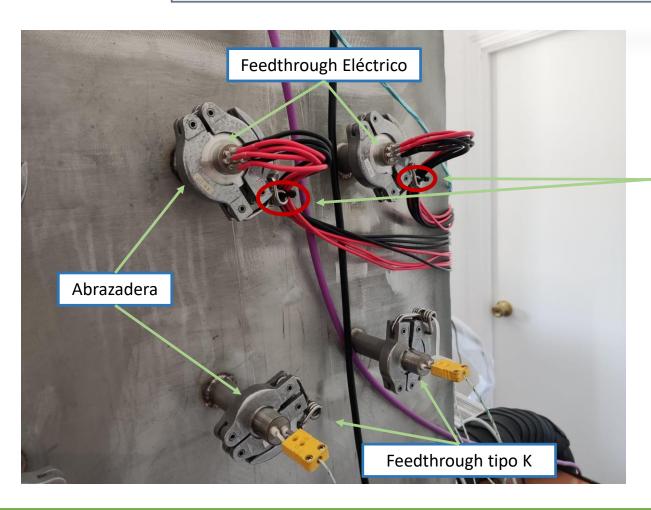
5. Diseño Mecánico: Montaje y Fabricación de la placa







5. Diseño Mecánico: Conexiones



Feedthrough Eléctricos

- Bombillas.
- Resistencias.
- <u>Brida</u>: Evita doblar las patillas del Feedthrough.
- <u>Termo-retráctiles</u>: Evita contactos entre cables.

Feedthrough tipo K

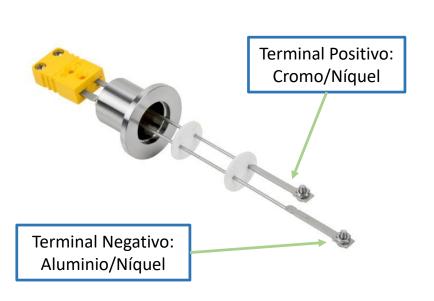
- Termopares
- Permiten la continuidad de los metales del termopar



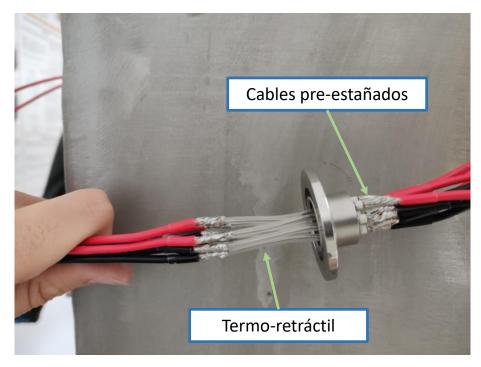


5. Diseño Mecánico: Conexiones

Feedthrough tipo K



Feedthrough Eléctricos





6. Diseño Software

TCP/IP

- AGILENT N6705A
- SIGLENT 3303X
- Comunicación por comandos SCPI en ASCII.
- Para la comunicación se ha usado el Pyvisa en Python.
- Dirección IP.

USB

- Vacuómetro
- Termómetro
- Comunicación serie.
- Para una correcta comunicación los parámetros seriales deben coincidir.

SCPI Commands				
Operation	SCPI AGILENT commands	SCPI SIGLENT commands		
Set voltage	VOLT:LEV Voltage, (@channel)	CHchannel:VOLT volt		
Set current	CURR:LEV Voltage, (@channel)	CHchannel:CURR volt		
Turn on a channel	OUTP ON, (@channel)	OUTPut CHchannel,ON		
Turn off a channel	OUTP OFF, (@channel)	OUTPut CHchannel,OFF		
Get voltage	MEAS:VOLT? (@channel)	MEAS:VOLT? CHch		
Get current	MEAS:CURR? (@channel)	MEAS:CURR? CHch		

Serial parameters				
	DataLogger Thermometer	Vacuumeter		
Port address	COM5	COM6		
Braud Rate	9600	19200		
Byte size	8	8		
Parity	None	None		
Stop bits	1	1		
Adress	-	123		

TCP/IP connection devices

	IP address	NetMask	Gateway
PC	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.1
AGILENT N6705A	192.168.2.4	255.255.255.0	192.168.2.1
SILENT 3303X	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1





6. Diseño Software

Paquetes usados en Python:

```
# PySerial for the access for the serial ports used
# by the vacuumeter and thermometer
import serial

7 # VXII1 package for the SIGLENT SPD3303X Power supply
import vxiI1

10 # PyVisa for the AGILENT N60705T DC Power Analyzer
import pyvisa as visa
```

Mandar información a la fuente por TCP/IP:

Pedir información a la fuente por TCP/IP:

```
# Method for getting the voltage of a channel:
def getVoltage(self, channel):
    # SCPI command: query operation
    self.scope.query(f'MEAS:VOLT? (@{str(channel)})")
• query()
```





GUI

TVAC DATA COLLECTOR

- · Thermometer port
- Vacuumeter port
- Security copy
- · Specification of the souces:
 - Voltage
 - Current
 - Outputs
 - IP address
- · Number max of iterations
- Start the main measurement loop
- Stop the loop and save the data

TVAC DATA PLOTTER

- To load excel file into DataFrame
- To select the x and the y axis
- · To plot
- · To fit the plots with a curve
- To specify the parameters of the curve
- Warning message if the curve cannot be fitted

TVAC SOURCES CONTROLLER

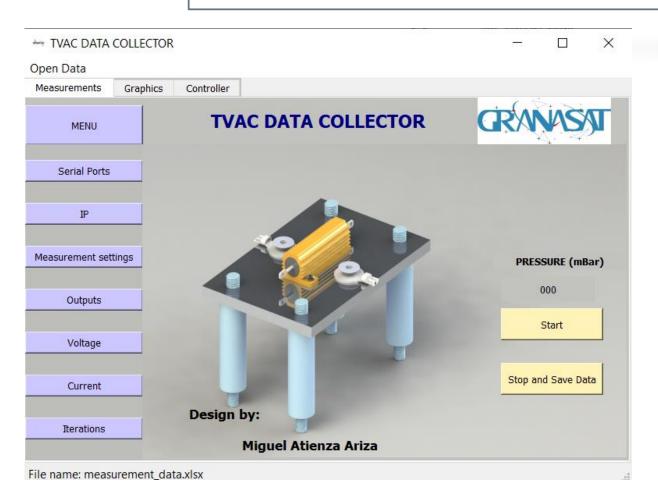
- · To connect the sources
- · To select the outputs
- Toet the voltage and current
- To display of the sources' state
- · To turn on/off the sources

Programación basada en eventos

- # Turn on button connected to turn_on method self.ON.clicked.connect(self.turn on)
- * # Turn off button connected to turn_off method self.OFF.clicked.connect(self.turn_off)



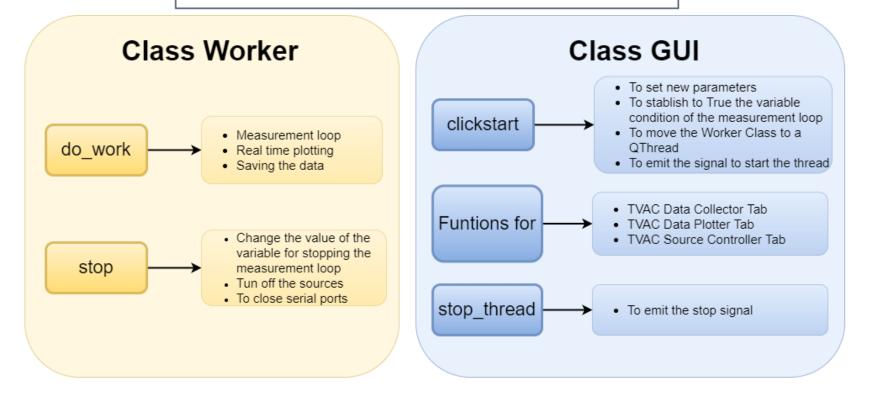




- Bucle de medida.
- Parámetros de los equipos de medida y suministro de potencia
- Parámetros para las conexiones TCP/IP y seriales
- Parar mediante:
 - Botón Stop
 - Ajustar iteraciones







MULTITHREADING

- Hilo para el bucle de medida
- Hilo para el GUI



Bucle de medida (método do_work)

Se inicia con el botón **START**.

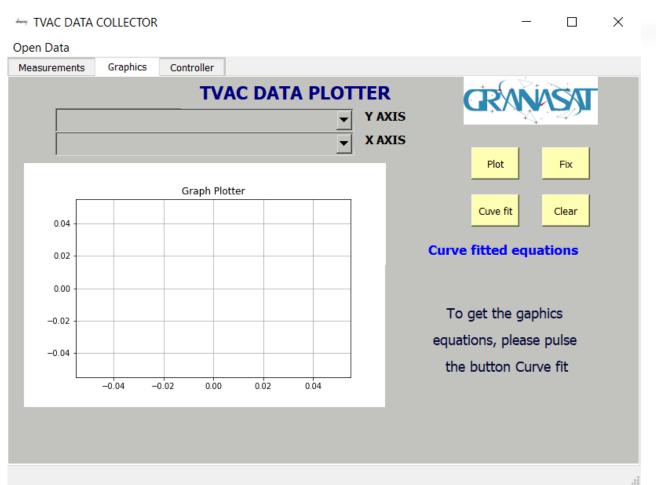
- Envía la información de los parámetros a las fuentes.
- Inicializa las gráficas y enciende las fuentes.
- 3. Empieza el bucle de medida:
 - Envía comandos query a las fuentes.
 - Datos en un DataFrame
 - Actualiza las gráficas
 - Cada ciertas iteraciones guarda el DataFrame en un archivo Excel (copia de seguridad)

Se termina con:

- Botón STOP:
 - Método stop() que niega la variable para parar el bucle
- Parámetro Iteraciones diferente a 0.
- Finaliza las gráficas en tiempo real
- 2. Cierra los puertos.
- 3. Guarda los datos en un archivo Excel.



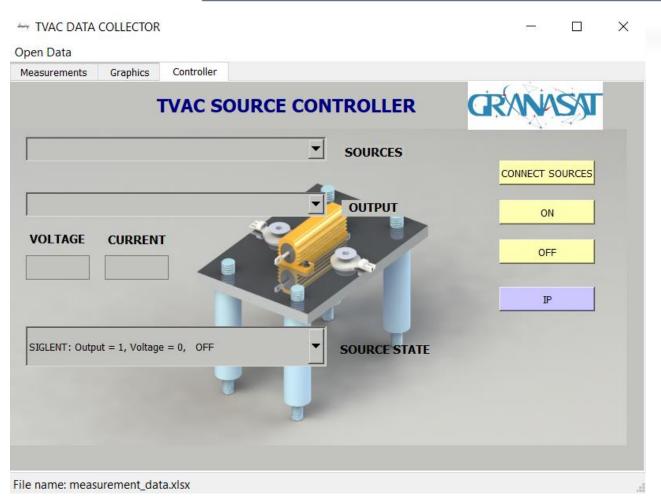




- <u>Plot</u>: Dibuja la gráfica a partir de los datos en X e Y
- <u>Fix</u>: Fijar la gráfica para dibujar encima.
- <u>Curve fit</u>: Ajustar datos experimentales.
- <u>Clear</u>: Borrar gráficas





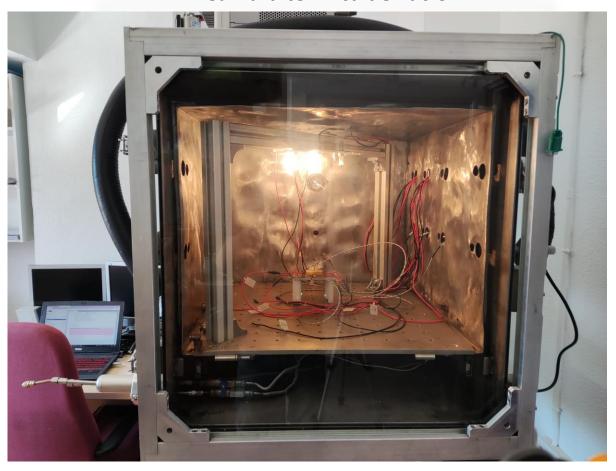


- Control de las salidas:
 - AGILENT N6075A
 - SIGLENT 3303X
- Visualización del estado de las salidas
- Encender y apagar las salidas de ambas fuentes
- Modificar direcciones IP





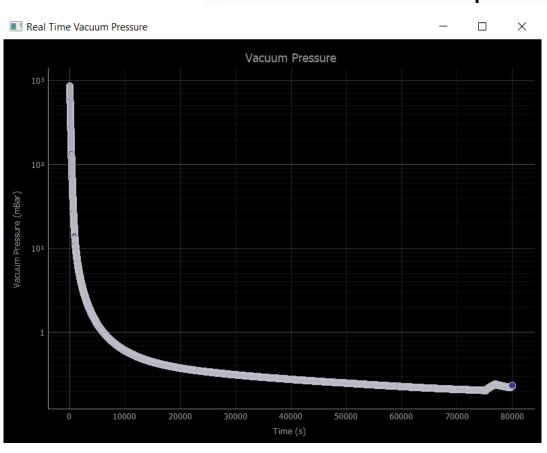
Cámara térmica de vacío







Gráfica en tiempo real



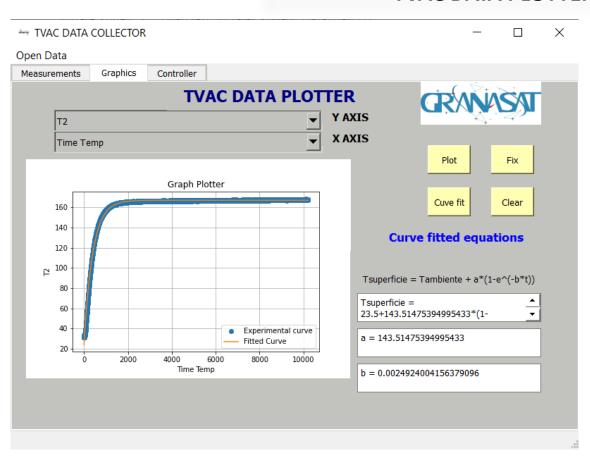
Gráficas en PYQTGRAPH:

- Datos en tiempo real
- Gran cantidad de datos
- No retarda el bucle de medición





TVAC DATA PLOTTER



- Ajuste experimental de datos
- Selección de datos del archivo Excel.
- Parámetros





TVAC DATA PLOTTER: BOTON FIX

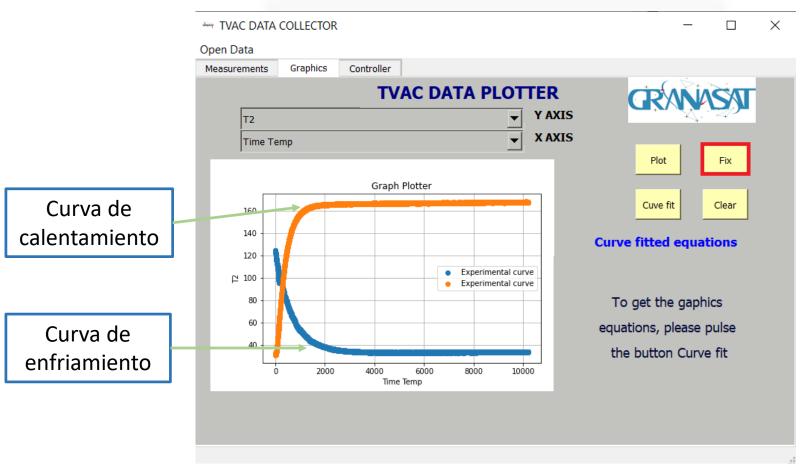




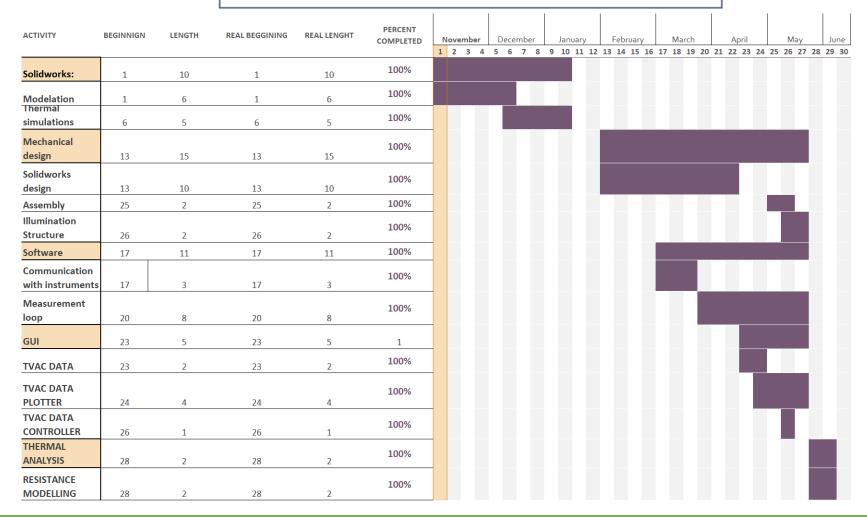








Diagrama de Gantt





PRESUPUESTO

PRESUPUESTO						
Artículo	Cantidad	Coste unitario (€)	Coste Total (€)			
Cable	56m	0.8	44.8			
Conectores de Banana	16	1.61	25.76			
Placa de aluminio	1	5.2	5.2			
Lámparas halógenas H7	4	0	0			
Termopares tipo K	4	18.3	73.2			
Cable de extensión	6m	0	0			
Conectores tipo K	3	0	0			
ARCOL HS50	1	0	0			
RS RS25	1	0	0			
Conectores Faston	20	0.05	1			
		Total	148.96			



8. Conclusiones

Resumen

- Sistema de medición y representación gráfica
 - Representación de datos en tiempo real
 - Tratamiento y ajuste de datos experimentales
 - Control de las fuentes de potencia.
- Acondicionamiento de la cámara para futuros ensayos
- Sistema de luz y calor para la TVAC

Líneas futuras

- Estudios térmicos a partir del sistema diseñado.
- Añadir más fuentes de voltaje disponibles en el laboratorio a la GUI
- Diseño de placas para estudios térmicos con otros modelos de resistencias como la ARCOL HS25.



INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Thermal Design and Simulation of a Circuit Board for Aerospace

TRABAJO FIN DE GRADO 2021-2022

Facultad de Ciencias

Autor: Miguel Atienza Ariza

Tutor: Andrés María Roldán Aranda

Departamento:

Electrónica y Tecnología de Computadores